

证券代码：688603

证券简称：天承科技

广东天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参会单位	长江证券、朱雀基金、淳厚基金、国联安基金、华宝基金、中信建投、中信证券、农银汇理、国金电子	
调研时间	2024年5月30日（周四）15:00-16:00	
会议地点	公司子公司会议室	
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：费维 证券事务代表：邹镭骏	
投资者关系活动主要内容记录	<p>（一）请问公司截止目前，2024年的营收情况和去年相比如何？</p> <p>答复：</p> <p>得益于下游电子电路行业景气度回升与公司新客户及下游电镀线的拓展，截止目前，公司24年的订单量和销售量同比都有不错的增长水平。</p> <p>（二）2024年天承在PCB电镀添加剂的增速如何，如何看待电镀添加剂国产化率提升速度？</p> <p>答复：</p> <p>电镀添加剂为公司核心推广产品，公司正努力不断推进各类PCB电镀添加剂产品的市场拓展，多个下游客户的产品验证环节也在持续进行中。</p> <p>目前国内PCB电镀添加剂的国产化率较低，电镀是公司重点发展的方向，公司的不溶性阳极直流和脉冲体系的产品，是真正能带动行业智能化发展的产品，适用于高端PCB的生产。随着技术的不断积累</p>	

	<p>和更多客户的认可，天承正逐步扩大 PCB 电镀添加剂产品销量，加速电镀添加剂的国产替代进程。</p> <p>（三）请问公司产品综合毛利率提升的原因是什么？水平沉铜方面的销售增速如何？</p> <p>答复：</p> <p>公司产品综合毛利率提升的主要原因为高毛利产品电镀添加剂的销售比例增加，另外公司通过升级配方、优化生产的方式不断实现降本增效。</p> <p>公司水平沉铜添加剂 SkyCopp 365X 系列产品获得了行业广泛认可，为公司核心产品之一，目前已经将数十条原为国际知名电子化学品供应商的产线替换，实现了进口替代。公司正持续不断的推进水平沉铜添加剂的下游扩展进度，实现该产品国产化率的进一步提升。</p> <p>（四）请问公司先进封装领域的电镀添加剂目前验证进展如何？</p> <p>答复：</p> <p>公司先进封装的产品主要聚焦于 RDL、bumping、TSV 和 TGV, 其相关的电镀添加剂已经研发完成，并处于下游客户持续验证阶段，目前获得的测试结果都较好，符合客户的预期，后续将接受终端客户的验厂。同时关于大马士革电镀液产品，公司也正在积极研发中。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 31 日